

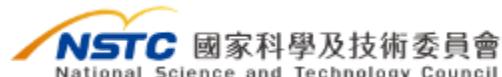


IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

Pitch Contest

- » シリコンアイランドの強みを活かしてグローバル市場へ
- » 国際的なスタートアップ企業と海外からの投資を台湾へ
- » 日本スタートアップにとっても大きなビジネスチャンス

Organizer:



Co-Organizer:



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

IC 分野に強みを持つ台湾との協業
AIが創り出す新しいビジネス
異業種連携による共創

- » シリコンアイランドの強みを活かしてグローバル市場へ
 - » 國際的なスタートアップ企業と海外からの投資を台湾へ
 - » 日本スタートアップにとっても大きなビジネスチャンス
- 生成AIと半導体チップを組み合わせることによって業界全体のイノベーションを活性化
- 人材の教育、国際的な研究開発人材の育成に取り組み、豊富な人的資源を活用
- 「ヘテロジニアスインテグレーション」など異種チップ集積や先進技術を加速



- 5つの重点カテゴリーで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集
- 応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明記の上、ウェブサイトからお申し込みください。
- 応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。

Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台灣半導體產業強化プロジェクト「晶創台灣」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

- ・台湾の半導体チップ設計・製造業界との連携を計画しているスタートアップ企業・学術・研究機関・個人はすべて大歓迎です。
- ・提案には、コア技術、解決する課題、ビジネスモデル、市場開拓計画などを含める必要があります。

分野1

AIコア技術とAI
チップ

- ・サイバーセキュリティ
- ・量子コンピューティング
- ・デジタルエコノミー

分野2

スマート
モビリティ

- ・電気自動車
- ・自動運転
- ・スマートシティ

分野3

スマート
マニュファクチャリング

- ・IC 製造プロセス
- ・ロボット工学

分野4

スマート
メドテック

- ・デジタルヘルス
- ・生体認証
- ・スマートモニタリング

分野5

持続可能性
(サステイビリティ)

- ・持続可能なモノづくり
- ・省エネイノベーション
- ・再生可能エネルギー



- 5つの重点カテゴリーで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集
- 応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明記の上、ウェブサイトからお申し込みください。
- 応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。

Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台灣半導體產業強化プロジェクト「晶創台灣」

スタートアップとのコラボレーション、世界中から技術やソリューションの提案を募集

試作から生産の領域まで半導体製造に関する台湾の‘強み’を活かしたマートナーのマッチングを実現

EDA/IP/IC設計

EDA & IP
アナログ・デジタル処理回路
IC設計サービス

システムインテグレーション

SI Development Factory
モジュール・インテグレーション
ニッチ製品市場開拓

ウェーハ製造

チップ製造
ウェーハシャトルサービス
パッケージとテストの
サプライチェーン
先進パッケージ・テスト



Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台灣」

Mentors & Partners

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

產業界

arm

M31

cadence

GUCSIEMENS

MEDIATEK

eMEMORY

PSMC

iSTART

tsmc
FARADAY

UMC
聯華電子

SYNOPSYS
CMSC

廣達電腦
COMPAL

英業達
Inventec

wistron
維創資通
PEGATRON
日月光集團



Bor-Sung Liang
Senior Director, MediaTek

Brandon Wang
VP, Synopsys

Henry Lee
Former Technical Director, Sunplus

Jason Jeng
Technical Director, UMC

Jerome Hung
Vice President, M31

Konrad Young
Former Chief of RD Department, TSMC

Kris Peng
President, UMC Capital

Kevin Wei
Sr. Business Development, Synopsys



Ken Li
Formal President, Rafael Microelectronics

Louis Lin
Senior Vice President, GUC

Michel Chu
President, ITIC

S. Z. Chang
Vice President & CTO, PSMC

Todd Lin
COO, EgisTec

Tsun-Jen Hou
Former RD Director, Faraday

Tsung-Ching Wu
Co-founder and Executive of Vice President, Atmel

Weining Shen
Partner, MediaTek Capital

アクセラレータ

比翼加速器
BE Accelerator

MOSAIC

新創101
STARTUP101

TCA
台北市電腦公會
TAIPEI COMPUTER ASSOCIATION

flyingVest ventures

IAPS

SparkLabs
TAIWAN

TSIA
台灣半導體產業協會
Taiwan Semiconductor Industry Association

FOODLAND VENTURES 資本

ORBIT
STARTUPS

TTA
TAIWAN TECH ARENA

semi
國際半導體產業協會

NCLC
國家高速網路與計算中心
National Center for High-performance Computing

智慧半導體及永續製造學院
Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

業界団体

研究開発機関

大学

NRLabs 國家實驗室
台灣半導體研究中心
Taiwan Semiconductor Research Institute

工業技術研究院
Institute of Technology Research Institute

產學創新研究學院
I-Lab 寶研文大

國立中山大學
半導體及重點科技研究學院
College of Semiconductors and Advanced Technology, NTU

CuSR

國立臺灣大學 重點科技研究學院
Graduate School of Advanced Technology

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

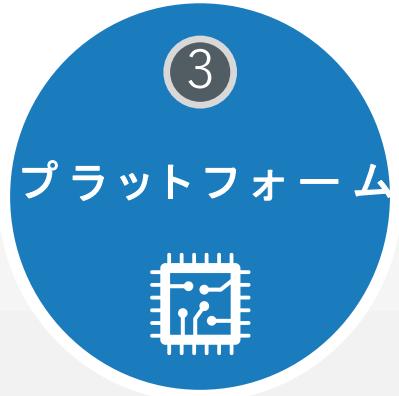


US \$30,000

- 2026 COMPUTEX/InnoVEXへの出展
- チームが台湾に到着してから支給



半導体業界の専門家による
ハンズオン支援



プロトタイプから製造まで
(EDAツール、ウェーハなど)



成功を確実にする
多面的なリソースとサービス

- 台湾のスタートアップエコシステムの主要
関係者が、受賞者を支援するためのリソ
ースを提供し、台湾での円滑な事業立ち
上げを実現します。

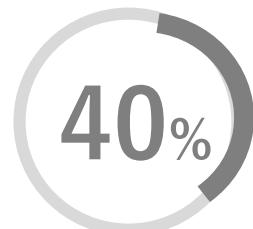


- 5つの重点カテゴリーで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集
- 応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明記の上、ウェブサイトからお申し込みください。
- 応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。

Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台灣半導體產業強化プロジェクト「晶創台灣」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



» 台湾で活用できるソリューションであること

台湾にニーズとマッチし、具体的な展開計画がある

台湾の産業にさらに幅広い展開の可能性をもたらす



» 新しい価値を創造するソリューションであること

技術革新を推進し、社会貢献できる

新しい新たな産業連携に貢献する、または産業のアップグレードを可能にする

資金調達や高い経済価値の創出を可能にする



» 革新的な技術を有していること

新興分野におけるイノベーションを保有

製造プロセス、設計、新素材の使用におけるイノベーションを推進

多様なイノベーションとクロスドメインの知識を統合

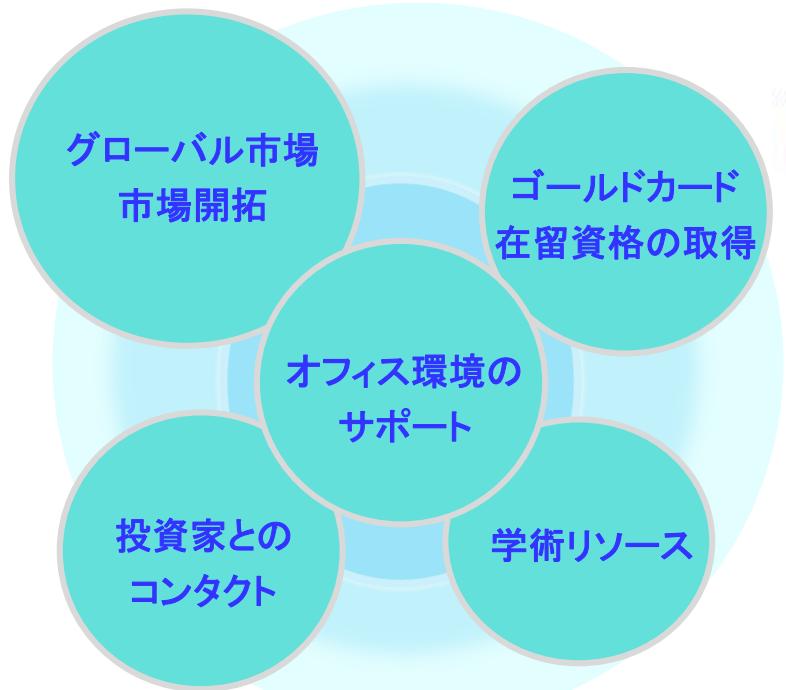


ピッチコンテスト審査基準

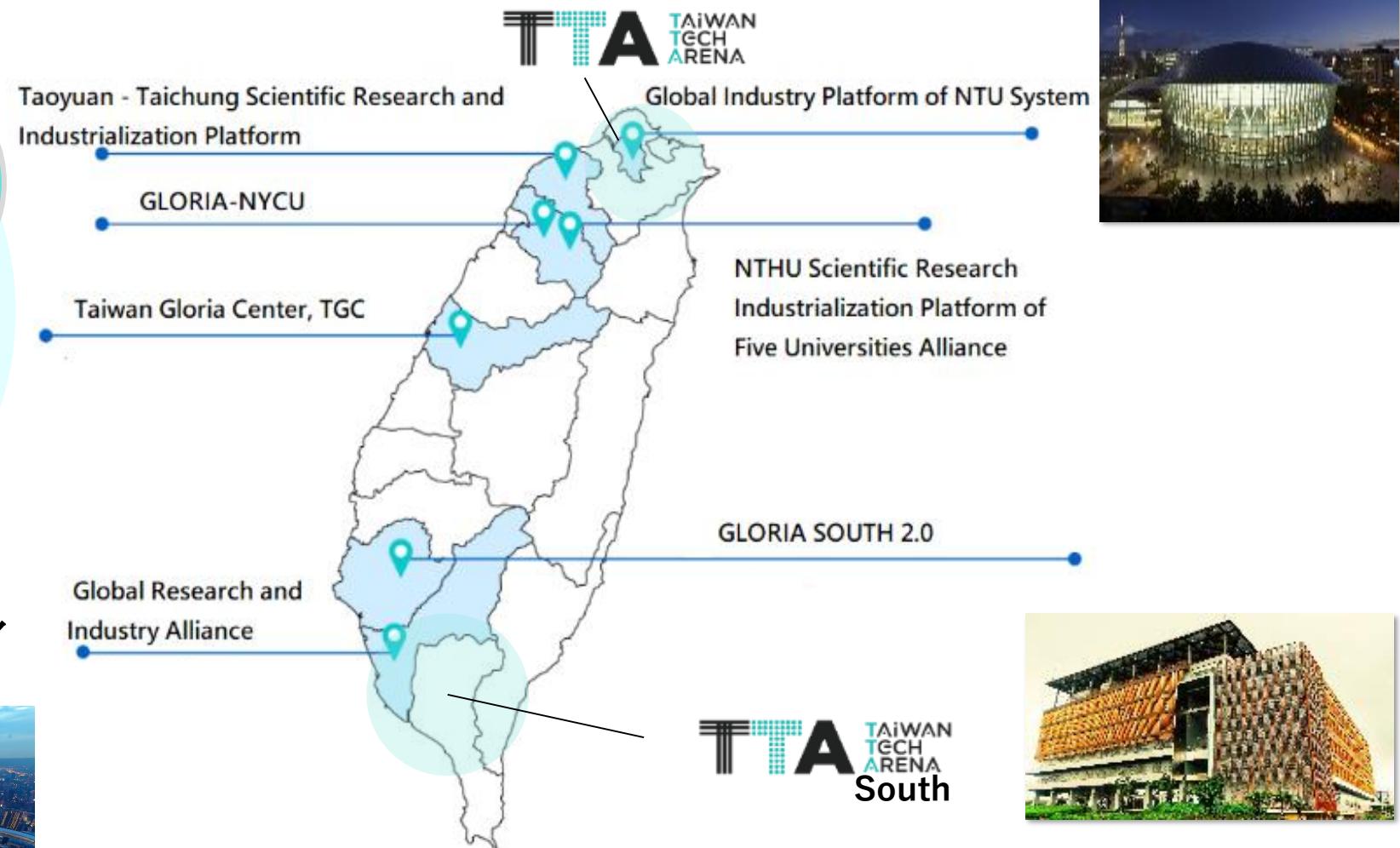
Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台灣」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



グローバル市場へのゲートウェイ

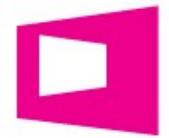


Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台灣」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

2025年11月1日
受付開始



COMPUTEX
TAIPEI

InnoVEX

2026年2月28日
締め切り

COMPUTEX & InnoVEX2026

受賞チームは6/2~6/5に台北で開催される展示会COMPUTEX & InnoVEXに出展資格が与えられます

申し込み受け付け期間

2025年11月より2026年3月まで

書類審査・オンラインプレゼン



ピッチコンテストスケジュール

Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台灣」



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

Pitch Contest

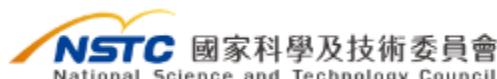
<https://ictaiwanchallenge.org>

Contact Us

Mr. Jacky Chen
jacky_chen@mail.tca.org.tw
+886 2 25774249 Ext. 940

Ms. Ariel Liu
ariel_liu@mail.tca.org.tw
+886 2 25774249 Ext. 825

Organizer:



Co-Organizer:

